С	OSTRUZIONI ELETTRONICHE		Data: 22 Luglio 2014		
Cognome		Matricola		Valutazione	
N	ome				
	mpo disponibile: 20' Ilutazione: Risposta esatta: 1; nes Non si possono consult			ata: -0.33.	
	ome si definiscono gli effetti di bassa affidab vasca da bagno? Bug nel controllo di qualità del processo pro Burn in Con prove accelerate ad alta temperatura e u Mortalità infantile	oduttivo	nti al tratto	iniziale della curva	
Pe	☐ La forma serve a chiarire e documentare nel simbolo la funzione stessa del pin nel chip ☐ La forma permette di associare il pin al conduttore corrispondente del footprint				
	sa indica KiCAD con i riferimenti U73A, Uvalore 74LS02?  4 porte NOR in 4 chip diversi Il riferimento è errato e verrà evidenziato da 4 porte NOR distinte in 2 chip diversi 4 porte NOR in un unico chip			i alle NOR di chip	
	tale grandezza fisica ha il principale impatt sistore di valore e dimensioni date? La capacità termica specifica del conduttore La conducibilità elettrica del conduttore La resistenza termica dell'isolante circostan La rigidità dielettrica dell'isolante circostan	te	nassima sop <sub>l</sub>	portata da un	
Qu	Sono facili da realizzare in tecnologia SMT Sono molto precisi Presentano bassa induttanza parassita Costano poco	tori a filo?			
	tale è l'affidabilità per il tempo di missione rallelo che presentano tasso di guasto costa 0,09% 0,9% 9% 90%				

Cosa significa l'acronimo RPN in una FMEA?  ☐ Relative Probabilistic Network  ☐ Rivelabilità, Probabilità, Numerosità  ☐ Risk Priority Number  ☐ Random Process Noise	
Nel disegno di vie tra due layer non contigui in un circuito multistrato occorre prestare attenzione a  □ Alla presenza di componenti in corrispondenza delle vie □ Al fatto che queste vie siano davvero disponibili nella tecnologia usata □ Alla presenza di pad SMT sottostanti o soprastanti, nei due layer esterni □ Alla presenza di aree metallizzate sottostanti o soprastanti, nei due layer esterni	
<ul> <li>Che cos'è una via "PTH"?</li> <li>□ Una strategia di routing con conduttori flessibili paralleli spessi (parallel thick hose)</li> <li>□ Una tecnica di annealing per evitare fuga termica nei conduttori interni (pretty thermal health</li> <li>□ Un foro metallizzato che attraversa tutto il PCB (plated through hole)</li> <li>□ Un percorso che passa in mezzo a due piazzole in uno strato interno (path through holes)</li> </ul>	h).
<ul> <li>Quali impostazioni possono darsi per l'annotazione di uno schema elettrico?</li> <li>Si devono indicare la directory in cui sono contenute le librerie con i simboli presenti nello schema</li> <li>Si può indicare un file di corrispondenza tra valore dei componenti e footprint da usare nel progetto geometrico</li> <li>Non ci sono impostazioni particolari per questa fase di progetto completamente automatica</li> <li>Si può decidere per l'annotazione incrementale o assoluta e dare indicazioni sull'ordine da seguire nella numerazione dei componenti annotati in funzione della loro posizione.</li> </ul>	
Come può essere fatta l'associazione tra simbolo elettrico e footprint nel progetto geometrico.  □ Tramite uno strumento grafico detto "ratsnet"  □ Tramite il file grafico che descrive lo schema, costituito essenzialmente da una mappa di bit.  □ Ponendo il nome del footprint selezionato in un apposito campo associato al simbolo elettrico o subito, durante il progetto elettrico, o in un secondo momento, con una apposita applicazio.  □ Non esiste un meccanismo di associazione: la scelta del footprint può essere fatta solo al live del progetto geometrico.	o, ne
<ul> <li>Quando si deve prestare attenzione all'impedenza caratteristica delle piste?</li> <li>☐ Quando le impedenze del circuito sono molto grandi.</li> <li>☐ Quando la lunghezza media delle piste del circuito è dell'ordine della lunghezza efficace, valutata tenendo conto del tempo di salita/discesa e della velocità di propagazione del segnal</li> <li>☐ Quando le frequenze in gioco superano i 100 MHz</li> <li>☐ Sempre</li> </ul>	le.
Quali sono le principali proprietà di un pad nel footprint che verrà associato a un simbolo corrispondente a un componente in uno schema elettrico?  □ Colore, spessore, lunghezza □ Forma, nome, tipo, numero □ Forma, dimensioni caratteristiche, dimensioni e forma del foro, layer coinvolti □ Resistenza, induttanza, capacità parassita	

si al	ale procedura occorre seguire per valutare l'affidabilità di un componente semplice di cui bbiano disponibili molti esemplari?  L'attribuzione di parametri di frequenza, gravità e rivelabilità a ogni tipologia di guasto L'analisi dettagliata dei guasti rilevati durante il normale funzionamento del componente La valutazione teorica delle relazioni funzionali tra gli elementi fisici del componente e della relativa affidabilità eseguita rapidamente tramite computer L'esposizione di lotti del componente a condizioni ambientali e di temperatura limite e la presenza di modelli matematici di accelerazione
com	ali strumenti aiutano il progettista nella scelta del componente più adatto, nei cataloghi di nponenti in rete?  Non esistono particolari strumenti per aiutare il progettista in questo compito  Elenchi alfabetici per numero di serie  Motori di ricerca e filtri di selezione parametrica  Liste di "cross reference"
indi poi □	anto vale l'affidabilità di un sistema, funzionalmente costituito da 6 sottosistemi uguali ipendenti di affidabilità 0,7 funzionalmente posti in modo che siano a coppie in parallelo e tutte le coppie in serie tra loro? 1,2 0,75 0,57 0,7
tecn	e relazione esiste tra volume ed energia accumulabile, per un condensatore di data nologia?  L'energia è proporzionale al quadrato del volume  L'energia è inversamente proporzionale al volume  L'energia è indipendente dal volume  L'energia è proporzionale al quadrato del volume
	un condensatore reale, quale grandezza viene modellata dala ESL?  Lo skin effect  Le perdite nel dielettrico per polarizzazione e dovute alla resistenza dei conduttori  L'induttanza parassita dei reofori collegati alle armature  La corrente di perdita attraverso il dielettrico
	Ando occorre prestare attenzione alla resistenza parassita delle piste?  Quando le frequenze in gioco superano i 100 MHz  Quando le piste del circuito sono più lunghe di un sesto della lunghezza efficace, valutata tenendo conto del tempo di salita/discesa e della velocità di propagazione del segnale.  In circuiti di precisione, quando le impedenze del circuito sono inferiori all'ohm.  Sempre
	<b>quali motivo a volte si lascia un traferro negli gli induttori avvolti su nucleo in ferrite?</b> Il traferro migliora la linearità senza penalizzare troppo il valore di induttanza ottenuto

	Il traferro riduce la resistenza serie parassita dell'induttore, migliorandone il Q Per ottenere valori di induttanza più elevati Sono più facili da realizzare
Che	e tipo di package viene indicato dalla sigla SSOP30? È il package assiale tipico dei resistori through hole di potenza lunghi 30 mm È il package SMD di un circuito integrato rettangolare a basso profilo con 7 e 8 pin per lato Un package rettangolare sottile SMD caratterizzato da 15 pin per ciascuna di 2 linee parallele Un package quadrato per SMD con le connessioni sulla faccia inferiore poste a matrice 6x5
	ale spiegazione può darsi al fatto che, al termine del progetto e prima dell'annotazione, in schema elettrico due simboli hanno la stessa posizione e orientamento?  Si tratta di un fatto normale per componenti uguali tra loro  Il CAD impedisce di usare per due simboli con riferimenti diversi la stessa posizione  Tutti i simboli con la stessa posizione indicano il medesimo componente  Si tratta di un errore di progetto, che verrà evidenziato dalla verifica delle regole
	rquale motivo alla fine del progetto elettrico è bene eseguire una verifica delle regole mali di progetto?  Perché comunemente, per non rallentare il disegno, durante il progetto elettrico il CAD esegue solo verifiche elettriche parziali e limitate al solo foglio corrente  Per evidenziare comuni errori di disegno o distrazione che hanno determinato situazioni elettricamente incoerenti o errate  La verifica elettrica finale tiene conto anche dei risultati della simulazione elettrica  Non è vero: esiste per il progetto elettrico una verifica in linea che dà sufficienti garanzie
	sa rappresenta, nello schema elettrico, una crocetta posta in corrispondenza di un pin in un abolo? Il fatto che il pin deve essere lasciato sconnesso Una simbolo grafico prodotto dal programma di verifica per indicare un errore di progetto Un simbolo grafico che indica la necessità di eseguire una saldatura sul PCB corrispondente Rappresenta l'esistenza di una connessione con i fili in prossimità
<b>Qu</b>	ali elementi influenzano principalmente la scelta della dimensione di una pista nel PCB?  La tensione a cui sarà sottoposta la pista e la corrente massima che sopporta  La sovratemperatura dovuta alla corrente efficace, la resistenza parassita e la resa del processo  La frequenza del segnale trasportato  La potenza dissipata dai componenti collegati
Ch	e differenza c'è tra via sepolta e via cieca?  La via cieca permette di connettere strati non adiacenti  La via sepolta riguarda strati interni, quella cieca unisce uno strato estremo con uno o più strati adiacenti  Nessuna, sono diverse definizioni della stessa cosa  La via cieca, a differenza di quella sepolta, prevede un processo di planarizzazione per evitare deformazioni degli strati adiacenti

Quali informazioni fornisce al progettista l'azienda che realizza il PCB?

	Le regole geometriche per garantire una buona resa ed evitare problemi di produzione I datasheet dei componenti elettronici usabili e vincoli per lo schema elettrico I file per le maschere prodotti dal CAD e quelli per la foratura La stampa a colori di esempi indicativi per tutti i layer del PCB
Ch	e cosa è in KiCAD il layer "edge.cuts"?  Il layer che rappresenta il contorno della scheda e le cave da fresare  Una rappresentazione grafica delle connessioni tra i pin dei moduli ottenuta congiungendo con linee dritte sottili i pad collegati tra loro  Una rappresentazione grafica della scheda in cui i footprint sono sostituiti da rettangoli colorati Il layer che indica dove deve essere posto lo strato polimerico che protegge le piste e le altre aree del PCB durante la saldatura, sul retro della scheda
	s'è un guasto occasionale? È un guasto che può sparire senza lasciare tracce È un guasto occasionalmente incompatibile con lo svolgimento della funzione del circuito È un guasto che insorge casualmente in un preciso esemplare prodotto È un guasto dovuto a un errore nella fase di progetto e sfuggito al debug
ma	
Qu	anto vale la velocità di propagazione del segnale in una linea di trasmissione senza perdite?  La radice quadrata del rapporto tra impedenza per unità di lunghezza e ammettenza per unità di lunghezza.  È data dal prodotto della resistività del materiale conduttore per il doppio della lunghezza della linea, diviso per la sezione del conduttore.  L'inverso della radice quadrata del prodotto tra permeabilità magnetica e permittività elettrica del materiale circostante  La radice quadrata del rapporto tra ammettenza per unità di lunghezza e impedenza per unità di lunghezza.